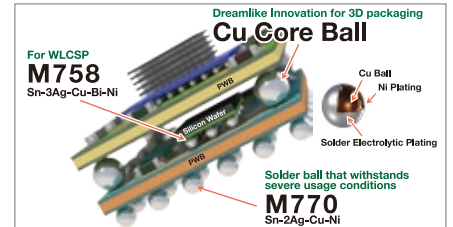


## ボイド発生のないソルダボールで、狭ピッチ実装を実現

Achieved fine-pitch mounting through solder balls with no void formation

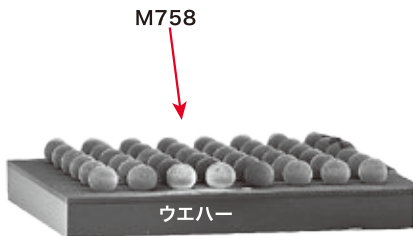
### 特長

- 独自の工法で、高真球度&狭公差ボールを実現
- 各種合金をラインナップ、用途に応じた材料の選択が可能
- ソルダボール実装は、ボイドが発生しない

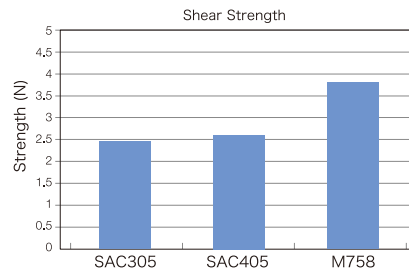


### 仕様

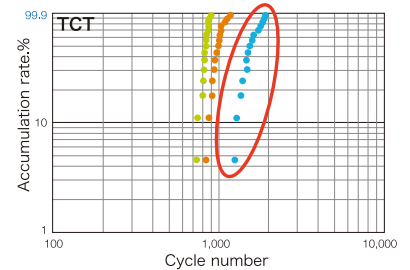
- ウエハーへのバンプ形成には、M758が最適



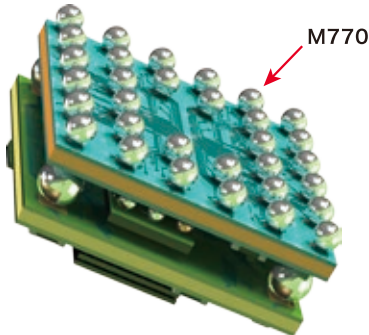
- M758は、Wafer電極に接合強度の高いバンプを形成



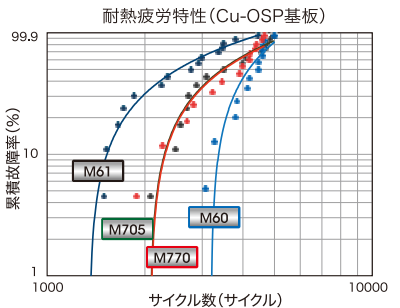
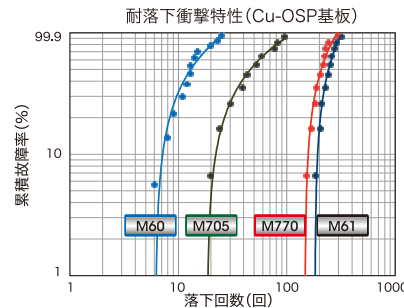
M758は、Ni添加による界面改質効果によりPKGレベルで良好なバンプ強度を有する



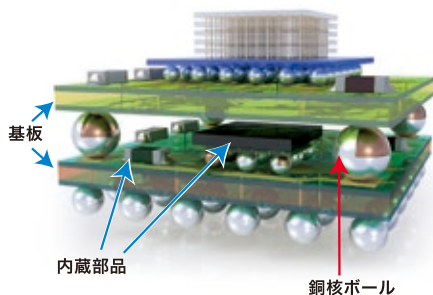
- 基板へのバンプ形成には、M770が最適



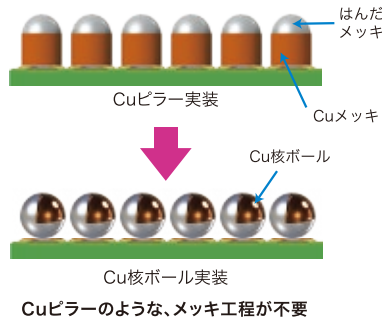
- 耐熱疲労特性と耐落下衝撃性を両立



- 部品内蔵化や狭ピッチ実装には、銅核ボールが最適



- 従来設備で、狭ピッチ実装が可能



- その他の合金

ラインナップ	
Φ30μmからΦ100μmまで、各種サイズをラインナップ	
鉛フリーの標準的材料	
<b>M705</b>	Sn-3.0Ag-0.5Cu
溶融温度 (°C)	(固相) 217 (液相) 220
耐熱疲労特性に優れた	
<b>M60</b>	Sn-2.3Ag-Ni-Co
溶融温度 (°C)	(固相) 221 (液相) 222
無銀で柔らかな鉛フリーはんだ	
<b>M200</b>	Sn-0.7Cu
溶融温度 (°C)	(固相) 227 (液相) 227
低融点鉛フリーはんだ	
<b>L20</b>	Sn-58Bi
溶融温度 (°C)	(固相) 139 (液相) 141